

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-001

芯联集成电路制造股份有限公司

2024 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现营业收入约为 65.09 亿元，与上年同期相比增加约 11.85 亿元，同比增长约 22.26%。其中实现主营收入约 62.76 亿元，同比增长约 27.79%。

（2）预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润约-9.69 亿元，与上年同期相比减亏约 9.89 亿元，同比减亏约 50.51%。

（3）预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约-13.87 亿元，与上年同期相比减亏约 8.75 亿元，同比减亏约 38.68%。

（4）预计 2024 年年度实现 EBITDA（息税折旧摊销前利润）约 21.19 亿元，与上年同期相比增加约 11.94 亿元，同比增长约 129.08%。

（三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(1) 营业收入：53.24 亿元。

(2) 归属于母公司所有者的净利润：-19.58 亿元。

(3) 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-22.62 亿元。

(4) EBITDA（息税折旧摊销前利润）：9.25 亿元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）循环驱动，多维布局，营收实现快速增长

2024 年，全球半导体市场稳态复苏。新能源汽车和智能网联汽车的“两新”政策的推动，以及汽车电动化和智能化技术的进步，新能源汽车市场发展显得尤为强劲。同时，高端消费电子领域的创新需求充分推动换新热潮，拉动电子产品消费，驱动消费行业的复苏。

受益于市场需求的增长，凭借公司拥有与国际比肩的技术，报告期内，公司实现主营收入约 62.76 亿元，同比增长约 27.8%；其中，车载领域收入同比增长约 41.0%，消费领域收入同比增长约 66.0%。从产品结构来看，公司 SiC MOSFET、12 英寸硅基晶圆等新产品在头部客户快速导入和量产，以 SiC MOSFET 芯片及模组产线组成的第二增长曲线和以高压、大功率 BCD 工艺为主的模拟 IC 方向的第三增长曲线快速增长，使得公司营业收入快速上升。

(1) 公司 12 英寸硅基晶圆产品实现收入约 7.91 亿元，同比增长约 1457%。公司立足于车规级 BCD 平台，拥有国际领先 BCD 工艺技

术和水平，是国内在该领域布局最完整的企业之一。报告期内，公司相继推出数模混合嵌入式控制芯片制造平台、高边智能开关芯片制造平台、高压 BCD 120V 平台，SOI BCD 平台等多个国内唯一/领先的高性能、高可靠性车规级 BCD 工艺技术平台，客户覆盖大部分国内主流设计公司，获得了车企多个项目定点。此外，中国智算中心产业迎来黄金发展期，在政策推动下多地积极落地智能计算中心项目。公司作为新能源产业的核心芯片供应商，正深度布局智算中心服务器电源等相关产品方案。

(2) 受益于电动化、智能化、网联化的发展，报告期内，公司持续保持碳化硅业务在产品和技术上的领先优势，拓展多家车载领域和工控领域国内外 OEM 和 Tier1 客户，实现规模化量产，是全球少数已实现规模量产的碳化硅芯片及模组供应商之一。2024 年，公司碳化硅业务已实现收入约 10.16 亿元。

(二)内生外延，首次实现全年毛利率转正，归母净利减亏超 50%。

报告期内，归属于母公司所有者的净利润约-9.69 亿元，同比大幅减亏约 50.5%；实现 EBITDA 约 21.19 亿元，同比增长约 129.1%；全年公司毛利率约为 1.1%，同比增长约 7.9 个百分点，首次实现全年毛利率转正；EBITDA 利润率约为 32.6%，同比增长约 15 个百分点。

公司立足于“市场+技术”双轮驱动，深入挖掘细分市场的客户需求，专注产品与服务的创新，提升技术含量，增强核心竞争力，不断扩大市场份额，规模效应逐渐显现。同时，公司通过持续

进行精益生产管理，改进生产流程、优化生产布局，实现生产效率的提升；通过优化生产要素组合、合理配置资源，降低生产成本，实现了归母净利润的大幅减亏。

2025年，预计新能源汽车市场需求还将在以旧换新的政策推动下不断扩大，以及汽车智能化和电动化带来的集成化需求，公司产品及技术储备的先发优势将会逐渐得到释放，为未来收入的持续增长提供保障。同时，随着公司精益化生产管理的进一步提升、成本结构的不断优化、8英寸晶圆生产线设备陆续出折旧期，公司的盈利能力将持续向好。

四、风险提示

截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025年1月16日